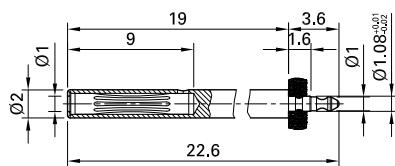


| Type<br>Type<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No.<br>No. de Cde | Nenn-Ø<br>Nominal Ø<br>Ø nominal | Anschlussvariante<br>Type of termination<br>Type de raccordement | Sandwichbauweise<br>Sandwich board construction<br>Construction étageée possible | Metallteile / Oberfläche<br>Metal parts / plating<br>Partie métallique / traitement | Auszugskraft<br>Withdrawal force<br>Effort de débouchage | Beimessungsstrom <sup>1)</sup><br>Rated current <sup>1)</sup><br>Intensité assignée <sup>1)</sup> | Kontaktwiderstand<br>Contact resistance<br>Resistance de contact |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| mm                   |  |                                  |  |  |   | N  | A   | mΩ   |

1:1 
**B1-T** **41.6002** 1 ④ ⑤ ✓ CuZn, Au ~1,5 20 ~1,2


Funktionen der Spezialkonturen im Anschlussbereich, siehe Seite 24

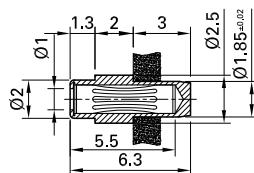
Functions of the special contours on the connection area, see page 24

Fonctions des contours spéciaux dans la zone de connexion, voir page 24

- ④ Lötzapfen  
⑤ Geeignet für Schwalllöten

- ④ Soldering pin  
⑤ Suitable for flow soldering

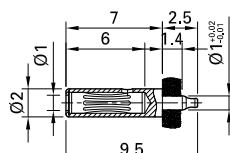
- ④ Picot de soudage  
⑤ Conv. pour soudure à la vague

1:1 
**B1-S** **41.6019** 1 ① ③ ✓ CuZn, Au ~3 20 ~1


- ① Platineneinbau  
③ Tauchlötfähig

- ① Circuit board installation  
③ Dip soldering

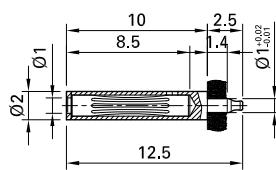
- ① Montage sur circuit imprimé  
③ Soudage par trempage

1:1 
**B1-A** **41.0001** 1 ③ ④ ✓ CuZn, Au ~3 20 ~1


- ③ Tauchlötfähig  
④ Lötzapfen

- ③ Dip soldering  
④ Soldering pin

- ③ Soudage par trempage  
④ Picot de soudage

1:1 
**B1-B** **41.0002** 1 ③ ④ ✓ CuZn, Au ~2 20 ~1,2


- ③ Tauchlötfähig  
④ Lötzapfen

- ③ Dip soldering  
④ Soldering pin

- ③ Soudage par trempage  
④ Picot de soudage

<sup>1)</sup> je nach Anschlussart und Querschnitt<sup>1)</sup> According to connecting method and cross section<sup>1)</sup> Selon le type de raccordement et la section du conducteur